

# ディップ製品の概要

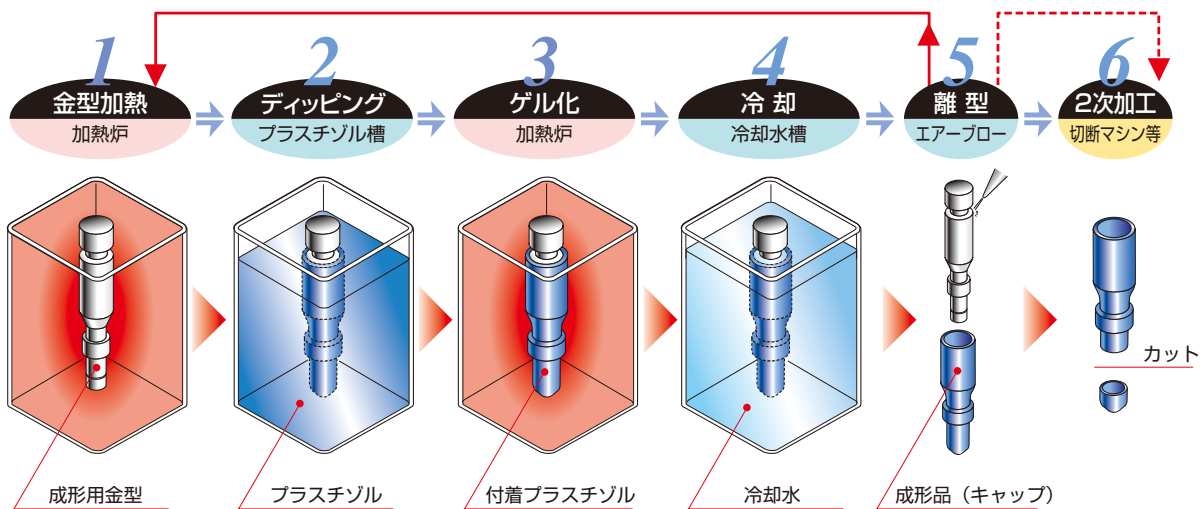
当社では、独自に開発した軟質塩化ビニル樹脂ゾルコンパウンド（鉛フリー）を使用して、ディップ成形により各種キャップ、カバーなどを一貫生産しております。当材料を使用して生産されるディップ製品は、電気絶縁性にすぐれるとともに、多数の製品にて信頼あるUL規格を取得しています。また、当社ディップ製品はRoHS指令（10物質）対応品です。

## ディップ製品の特長

- 電気絶縁性、耐熱老化性にすぐれています。
- 適度な柔軟性で電子部品、端子、電線等にフィットします。
- 無圧成形のため、製品の内部歪がなく熱老化時の変形が少ない。
- 成形用金型が安価で製作時間が短い。
- 表面の光沢性にすぐれ、豊富なカラーバリエーションがあります。

## ディップ製品のできるまで

- 1 成形用金型（雄型）を加熱炉で加熱します。
- 2 加熱した金型をプラスチゾル（ペースト状）に浸漬し、金型表面に付着させます。
- 3 再び加熱炉で加熱しゲル化させます。
- 4 金型とともに、冷却水槽で冷却します。
- 5 エアブローで金型から離型し、成形品となります。
- 6 製品によっては先端部を切断マシン等でカットします。



## 各種規格の登録・認定

### 電気用品安全法

登録番号	成形材料	使用温度の上限値
042GAC0435	SS107UFTT	105℃

### UL 規格認定（材料）

UL File No.	成形材料
E58538	SS107UFTT

### CSA 規格認定（製品）

CSA File No.	定 格
LR52853・LR52854	90℃－300V, 600V 105℃－300V, 600V

### UL 規格認定（製品）

UL File No.	定 格
E55167	105℃－300V, 600V

### ● UL 認証情報の検索

最新のUL 認証情報のご確認は Product iQ をご利用ください。ご利用の際は、アカウント登録（無料）が必要です。

〈検索キーワード〉

UL Product iQ

検索

ログイン後の検索ボックスに SHINAGAWA SHOKO と入力してください。各UL 認証情報を参照できます。（尚、ログインをせずに要約サイトのご利用も可能です。Product iQ アカウント登録画面からお進みください）

Q/A

9	
	z
x	ES
3/4	A
Y=H	
	o
Y=H	
	u w S ^
Y=H	
.	u
E	- ; 9
a	l
1	a EO
	e
	t
1	EO
1	l °
1	1/4 Q Z
	zS
< E t	

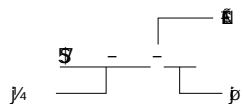
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A

Q/A

Q/A

Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A

Q/A  
Q/A



Ro	i	z	(	h	-	i	f	0
SS108			02	03		06		09
UL E SS107UFTT	i		22	23		26		S
UL E SS107UFTT	j		32	33		36		S
UL E SS107UF	o		S	S		S		S

Q/A  
Q/A

Q/A

Q/A

Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A

Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A  
Q/A